

Features

- ▶ AI 와이어 본딩
- ▶ 웨이퍼 프로브부터 테스트와 패키징까지 완벽한 턴키 서비스
- ▶ 친환경 재료 : 무연 도금 & 무할로겐 몰드 화합물
- ▶ 리드 선단 하부 도금 두께 : 리드 두께의 50% 이상

Under Development

- ▶ 친환경 무연 솔더 칩 어태치

Process Highlights

- ▶ 인터커넥트 : $\phi 125 \mu\text{m} \sim \phi 300 \mu\text{m}$ AI 와이어
- ▶ 도금: 100% matte Sn
- ▶ 마킹 : 레이저 마크

HSON8

HSON8 패키지는 표준 SOP8 패키지와 동일한 5 x 6 mm 풋프린트를 채용하고 있으며, 방열 성능 향상을 위해 노출된 칩 패드를 사용한 것이 특징입니다.

Applications

HSON8는 낮은 온-저항과 고속 스위칭 MOSFET용으로 설계된 중전력 애플리케이션(기준치 80W*/60A)에 적합합니다.

- ▶ 모터 드라이버
- ▶ 주입 드라이버
- ▶ 전원 공급 회로
- ▶ 램프 드라이버
- ▶ 자동차 제품

*Tc = 25°C, Tj = Max 150°C

Reliability Qualification

제이디바이스(J-Devices)의 패키지는 신뢰성이 입증된 반도체 재료로 제조됩니다.

- ▶ 고온방치(HTS)를 제외한 모든 신뢰성 테스트는 JEDEC 표준 전처리 요구사항을 포함합니다.
- ▶ 85°C/85%RH, 168 hours, IR reflow 260°C 3X
- ▶ PCT: 121°C/100% RH/2 atm, 96 hours
- ▶ 온도 사이클 : -55°C/+150°C, 300 cycles
- ▶ 고온방치(HTS) : 150°C, 1000 hours

Test Service

제이디바이스는 모든 Power discrete 제품에 대해 완전한 턴키 비즈니스를 제공하며, MOSFET과 지능형 전력 소자 등 다양한 유형의 전력 소자 테스트를 수행할 수 있는 능력이 있습니다.

- ▶ Power discrete 테스트 능력 :
 - ▷ DC
 - ▷ Capacitance *1
 - ▷ Rg *1
 - ▷ Avalanche test
 - ▷ 열 저항
- ▶ 프로그램 변환
- ▶ 전기적 불량 분석
- ▶ 통합 테스트, 마킹, 육안 검사와 테이프 릴 서비스

*1 Sampling test only

HSON8

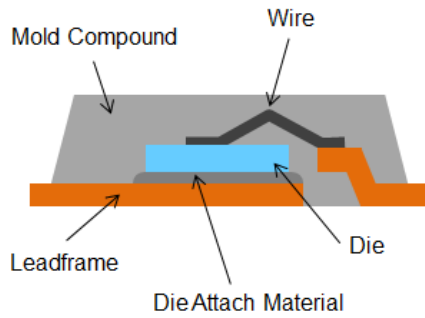
Standard Materials

- ▶ 리드프레임 : 와이어 본딩 부분에 니켈 도금한 구리
- ▶ 칩 어태치: 납 솔더
- ▶ 인터커넥트 : AI 와이어
- ▶ 몰드 화합물 : 무할로겐

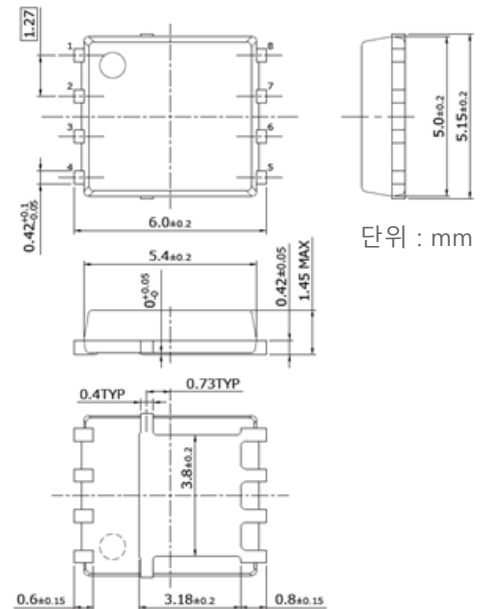
Shipping

- ▶ 테이프 및 릴 포장
 - ▷ 릴 당 2500개
 - ▷ 테이프 너비 12 mm
 - ▷ 릴 $\Phi = 330$ mm
- ▶ 바코드 패키징 라벨

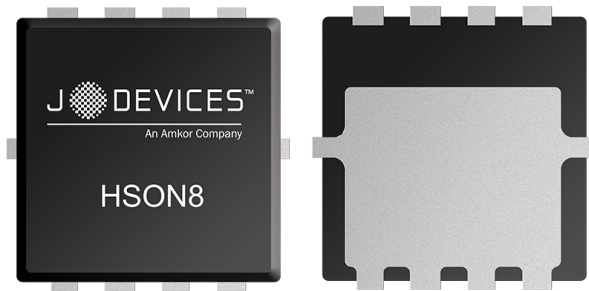
Cross-section



Package Outline Drawing



Top & Bottom View



자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 ATKQnA@amkor.co.kr로 이메일을 보내십시오.

본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지는 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다. © 2018, Amkor Technology Incorporated.

All Rights Reserved. DSJD407B Rev Date: 10/18

